



2024年5月10日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和
(コード番号 6315 東証プライム市場)
問 合 せ 先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 長 中 西 和 彦
TEL (075) 692 - 0251

当社子会社における固定資産取得（土地および建物）に関するお知らせ

当社は、100%子会社である TOWA 韓国株式会社（所在地：韓国）が同国において固定資産（土地および建物）を取得いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取得の理由

韓国地域では、生成 AI の普及などにより、先端半導体向けの設備投資が拡大しており、今後も半導体メーカー各社による積極的な投資が続くことが予想されます。

かかる状況下、韓国地域での半導体製造装置の生産体制を強化し、生産能力拡大と納期短縮を目的に工場資産を取得いたしました。既存建物を活用することで早期生産立ち上げが可能になります。

また、半導体製造装置の生産だけでなく、装置リニューアルビジネスやラボ機能の拡充にも使用する予定にしており、事業展開の拡大も視野に入れた活用を進めてまいります。

なお、今回の固定資産取得により、TOWA 韓国株式会社の生産能力を2倍にまで引き上げることが可能になります。

2. 取得資産の概要

所 在 地	大韓民国忠清南道天安市西北区車岩棟 425
土 地 の 総 面 積	16,136.70 m ² (約 4,881 坪)
延 床 面 積	6,215.03 m ² (約 1,880 坪)
投 資 金 額	非開示
引 渡 日	2024年4月29日

3. 今後の見通し

本件による影響につきましては、本日公表の 2025 年 3 月期の連結業績予想に含めております。なお、今期（2025 年 3 月期）の業績に与える影響は軽微ですが、今後開示すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

以 上